**《台灣半導體設備產業發展現況與未來趨勢》報名表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 司 |  | 電 話 |  |
| 地 址 |  | 傳 真 |  |
| 參加者姓名 | 職 稱 | 分機 | 手機 | E-mail |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 報名費用 | □一般報名，NT3,000元。 □早鳥優惠，享6折優惠價NT1,800元。 □TEEIA台灣電子設備協會、台灣半導體產業協會，享5折優惠價NT1,500元。 |
| 費用合計 | 新台幣 元整 |
| 報名聯絡人 |  | 連絡電話 |  | 職稱 |  |
| **繳款方式** |
| □現場繳費 (研討會當天現場繳費) □匯款繳費 □線上繳費※註1：若需當日研討會立即收到發票，請填妥發票資料欄，發票將於當日繳交報名費時一併給予。※註2：匯款繳費請將繳費單(匯款明細)傳真至07-3533978，並註明參加者姓名、公司。收款銀行：兆豐國際商業銀行─港都分行 (銀行代碼：017) 戶　　名：財團法人金屬工業研究發展中心 收款帳號：「00220009670」 (共11碼) 　　a. 劃撥/匯款人請詳細填寫報名單位名稱、姓名、電話。　　b. 劃撥/匯款後，請將收據影本連同報名表一併傳真至886-7-353-3978，以完成報名手續。　　c. 可使用ATM轉帳，轉帳後請將轉帳收據連同報名表一併傳真至886-7-353-3978，以完成報名手續。 |
| **發票資料欄** |
| 發票抬頭 |  | 統一編號 |  |
| 發票種類 | □ 二聯式(個人) □ 二聯式(非營利單位,不顯示統編) □ 三聯式 |

**財團法人金屬工業研究發展中心個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書**

本中心因受經濟部技術處委託執行/辦理台灣半導體設備產業發展現況與未來趨勢研討會之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條規定告知下列事項：

(一)蒐集目的：辦理本次活動及相關行政管理。

(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式等。現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。

(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。

(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。

(六)當事人權利：您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：07-3513121轉2360。

(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關服務。

**辦理本次活動外其他蒐集目的告知：**

蒐集目的：寄送本中心舉辦之活動或產業相關之訊息。

本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意 貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

 立書人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期： 年 月 日

* 報名表填妥請傳真至(07)353-3978，洽詢電話：(07)351-3121分機2337何小姐或2386劉小姐